

北京市君合律师事务所

关于

成都思科瑞微电子股份有限公司

首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市

之

补充法律意见书（一）



二〇二一年八月

北京市君合律师事务所

关于成都思科瑞微电子股份有限公司

首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市之

补充法律意见书（一）

致：成都思科瑞微电子股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”或“君合”）接受成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“思科瑞”、“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）的特聘法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）和《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等法律、行政法规、规章、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所就本次发行事宜于 2021 年 5 月 23 日出具了《北京市君合律师事务所关于成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市之律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《北京市君合律师事务所关于成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。

鉴于上交所向发行人下发了《关于成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）[2021]350 号）（以下简称“《审核问询函》”），本所现就《审核问询函》中要求本所律师核查的事项所涉及的法律问题，出具本《北京市君合律师事务所关于成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市之补充法律意见书（一）》（以下简称“本补充法律意见书”）。

本补充法律意见书是对《律师工作报告》和《法律意见书》的补充，并构成《律师工作报告》和《法律意见书》不可分割的一部分。除有特别说明之外，本所在《律师工作报告》和《法律意见书》中发表法律意见的前提、声明、简称、释义和假设同样适用于本补充法律意见书。对于本补充法律意见书所说明的事项，以本补充法律意见书的说明为准。

本所律师同意发行人按照中国证监会及上交所的审核要求引用本补充法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行所必备的法定文件，随同其他申报材料一同上报，并依法对本补充法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的有关事实进行了审查和验证，现出具本补充法律意见书。

正文

一、《审核问询函》问题 2

根据招股说明书，发行人董事、高级管理人员及核心技术人员马卫东 1989 年 7 至 2018 年 6 月历任中国人民解放军海军七〇一工厂工程师、副主任、主任，2018 年 8 月至 2020 年 5 月任成都思科瑞微电子有限公司总经理；独立董事林干 2016 年至 2018 年就职于空军研究院防空反导所总体室，任研究员。

请发行人说明：结合相关军队人员管理规范及党政干部管理规范，说明马卫东 2018 年入职发行人、林干担任董事是否违反相关保密规定、人员离职管理规范等，是否合法合规。

请发行人按照时间顺序完整披露董监高等人员的履历信息。

请发行人律师核查并针对上述人员入职的合法合规性发表明确意见。

回复：

（一）军队人员管理规范及党政干部管理规范等相关规范文件

1、军队人员管理规范

根据检索公开渠道的相关法律法规、规范性文件，军队人员管理规范主要包括现役军人、文职人员的管理规范，具体如下：

根据中央军委常务会议 2018 年 3 月 22 日审议通过的《中国人民解放军内务条令》，本条令适用于中国人民解放军现役军人和单位（不含企业、事业单位）以及参训的预备役人员。军人必须遵守国家、军队的保密法规，严守保密纪律，保守国家和军队的秘密。对于退出现役转业安置的军官和文职干部，则适用《军队转业干部安置暂行办法》《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》《关于自主择业军队转业干部安置管理若干具体问题的意见》《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》等相关政策规定。

根据中央军事委员会、国务院 2017 年 9 月 27 日修订并颁行的《中国人民解放军文职人员条例》，文职人员，是指在军民通用、非直接参与作战且社会化保

障不宜承担的军队编制岗位从事管理工作和专业技术工作的非现役人员。文职人员应当服从命令，听从指挥，遵守纪律，保守秘密。文职人员符合国家和军队规定退休条件的，应当退休。文职人员退休后，享受国家和军队规定的相应待遇。

此外，《人事部、劳动和社会保障部、中国人民解放军总后勤部关于军队后勤保障社会化改革中人事和劳动保障工作有关问题的通知》、《劳动和社会保障部办公厅、人事部办公厅、解放军总后勤部司令部关于对军队机关事业单位职工参加失业保险有关问题的复函》对于军队职工、军队机关事业单位职工参与社会保险等相关事项进行了专项规定。

2、党政干部管理规范

根据中共中央组织部于 2013 年 10 月发布的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18 号），现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）；对辞去公职或者退（离）休的党政领导干部到企业兼职（任职）必须从严掌握、从严把关，确因工作需要到企业兼职（任职）的，应当按照干部管理权限严格审批。

根据教育部办公厅于 2015 年 11 月发布的《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函[2015]11 号），党政领导干部包括部机关、直属单位及其内设机构、直属高校及其院系等副处级以上干部。

3、保密相关规定

根据全国人民代表大会常务委员会 2010 年 4 月 29 日修订通过的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在涉密岗位工作的人员，按照涉密程度实行分类管理。涉密人员离岗离职实行脱密期管理。涉密人员在脱密期内，应当按照规定履行保密义务，不得违反规定就业，不得以任何方式泄露国家秘密。国家机关和涉及国家秘密的单位管理本机关和本单位的保密工作。

根据国家保密局 2018 年 10 月 24 日在其官网上发布的关于涉密人员离职管理的相关信息¹，离职的涉密人员须做到“三个不得”：一是不得擅自出国（境）。二是不得到境外驻华机构、组织或者外资企业工作。三是不得为境外组织、人员或者外资企业提供劳务、咨询等服务。

¹ <http://www.gjbmj.gov.cn/n1/2018/1024/c409092-30360313.html>

根据上述规定，本所律师认为，（1）上述文件并不禁止离职涉密人员在脱密期内就业，但该等人员在脱密期内须履行保密义务，不得存在泄露国家秘密、擅自出国（境）、到境外驻华机构、组织或者外资企业工作、为境外组织、人员或者外资企业提供劳务、咨询等服务等违反保密相关规定的情形（以下简称“**脱密期行为规范**”）；（2）对于从涉及国家秘密的单位离岗离职的涉密人员，由原单位对其实行脱密期管理。

（二）马卫东 2018 年入职发行人的合法合规性

根据马卫东出具的调查表、其与中国人民解放军海军七〇一工厂（以下简称“**海军七〇一工厂**”）签署的聘用合同、海军七〇一工厂分别于 2020 年 3 月 21 日及 2021 年 6 月 29 日出具的说明文件及本所律师对马卫东的访谈：（1）马卫东于 1989 年 7 月至 2018 年 6 月任职于海军七〇一工厂，当时与海军七〇一工厂签署的是聘用合同，属于军队职工，不属于现役军人或文职人员，亦未担任党政领导干部，不属于军队转业干部；（2）马卫东的脱密期为两年（自 2018 年 6 月至 2020 年 5 月），马卫东确认其在此期间始终遵守脱密期行为规范；（3）2020 年 3 月 21 日，海军七〇一工厂政治处出具《说明》：马卫东已办理完毕离职手续，允许其自 2018 年 6 月起自谋职业，截至目前未发现马卫东存在违反该单位保密相关规定的情况，该单位与马卫东无争议或纠纷；（4）2021 年 6 月 29 日，海军七〇一工厂政治处出具《证明》：马卫东为该单位原在职职工，现脱密期已满，在该单位办理了脱密手续，至脱密期结束，未发现马卫东有违反保密规定的情况。

结合上述情况，本所律师逐项对照第（一）部分“军队人员管理规范及党政干部管理规范等相关规范文件”就马卫东入职发行人的合法合规性进行了核查：（1）马卫东不属于现役军人、军转干部、文职人员，其在海军七〇一工厂离职前属于军队职工；经核查，马卫东入职发行人的行为没有违反上文中针对军队职工的相关规定；（2）马卫东不曾担任过党政干部，因此不适用上文中党政干部管理规范；（3）马卫东离开原涉密岗位后有两年脱密期，但负责对其进行脱密期管理的海军七〇一工厂政治处已出具《证明》，确认马卫东脱密期已届满，且迄今没有违反保密规定。

因此，马卫东 2018 年入职发行人合法合规，未违反相关保密规定、人员离职管理规范。

（三）林干 2020 年担任发行人独立董事的合法合规性

根据林干出具的调查表、林干提供的文职干部证、文职干部退休证、中国人民解放军空军研究院防空反导研究所（以下简称“**防空反导研究所**”）综合办公室于 2021 年 7 月 8 日分别出具的说明文件及本所律师对林干的访谈：（1）林干自 2016 年 8 月至 2018 年 11 月任职于防空反导研究所，属于文职干部，但不属于党政领导干部；（2）林干于 2018 年 11 月办理完毕退休手续，不属于军队转业干部；（3）林干的脱密期为两年（自 2018 年 11 月至 2020 年 11 月），林干确认其在此期间始终遵守脱密期行为规范；（4）2021 年 7 月 8 日，防空反导研究所出具《证明》：林干已办理完毕退休手续，脱密期已届满，截至 2021 年 7 月 8 日，未发现其存在违法违纪及违反脱密期规定事项。

结合上述情况，本所律师逐项对照第（一）部分“军队人员管理规范及党政干部管理规范等相关规范文件”就林干入职发行人的合法合规性进行了核查：（1）林干入职发行人时已经从防空反导研究所正式退休，不属于现役军人、军转干部、文职人员、军队职工，亦不违反上文中军队人员管理规范的具体规定；（2）林干不曾担任过党政干部，因此不适用上文中党政干部管理规范；（3）林干离开原涉密岗位后有两年脱密期，但负责对其进行脱密期管理的防空反导研究所已出具《证明》，确认林干脱密期已届满，且迄今没有违反保密规定。

因此，林干 2020 年担任发行人独立董事合法合规，未违反相关保密规定、人员离职管理规范。

此外，根据发行人提供的相关资料、发行人除马卫东、林干之外的其他董事、监事、高级管理人员填写的调查表及本所律师对其进行的访谈，上述人士在入职发行人前均不属于现役军人、军转干部、文职人员、军队职工或党政领导干部，上述人士入职发行人均合法合规。

（四）核查程序

就上述问题，本所律师履行了如下核查程序：

1、从公开渠道检索了关于保密及人员离职管理相关的军队人员管理规范及党政干部管理规范；

2、取得并查阅了马卫东、林干出具的调查表，并对马卫东、林干进行访谈；

3、取得并查阅了马卫东与海军七〇一工厂签署的聘用合同、海军七〇一工厂政治处分别于2020年3月21日、2021年6月29日出具的说明文件；

4、取得并查阅了林干的文职干部证、文职干部退休证及防空反导研究所综合办公室于2021年7月8日出具的说明文件；

5、取得并查阅了发行人除马卫东、林干之外的其他董事、监事、高级管理人员提供的简历、调查表，并对上述人士进行访谈。

（五）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、马卫东2018年入职发行人、林干2020年担任发行人独立董事合法合规，未违反相关保密规定、人员离职管理规范；

2、除马卫东、林干之外，发行人的其他董事、监事、高级管理人员在入职发行人前均不属于现役军人、军转干部、文职人员、军队职工，也不曾担任党政领导干部，上述人士入职发行人合法合规。

二、《审核问询函》问题3

根据招股说明书，报告期内发行人及子公司存在员工由其他单位缴纳社保、公积金的情形以及未开设住房公积金账户的情形。

请发行人说明：由其他单位缴纳社保、公积金的原因及合理性，是否合法合规；针对未开户的情形，当前的整改情况。

请发行人律师核查并针对发行人当前有关社保、公积金事项的合法合规性发表明确意见。

回复：

（一）由其他单位缴纳社保、公积金的原因及合理性，是否合法合规

根据发行人提供资料及其书面确认，2018年末及2019年末，发行人及其子公司存在少量员工（7名）曾经在其他单位缴纳社保、公积金，均系该等员工出于个人原因在其他单位缴纳（包括员工经常居住地在外地，长期在经常居住地缴

纳,或者未及时办理社保公积金转移手续仍在原单位缴纳),具有一定的合理性。

根据《中华人民共和国社会保险法》,用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。未办理社会保险登记的,由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费。根据《住房公积金管理条例》,用人单位录用职工的,应当自录用之日起 30 日内向住房公积金管理中心办理缴存登记,并办理职工住房公积金账户的设立或者转移手续。

根据上述规定,发行人未及时为其员工缴纳社保及公积金存在法律瑕疵,但鉴于:(1)由其他单位缴纳涉及人数较少,且系员工个人原因所做的自愿选择,公司已就上述情况进行整改,截至报告期末,公司不存在由其他单位为发行人职工缴纳社保的情形;(2)相关员工已经出具书面承诺,承诺不会因此向发行人主张任何赔偿,与发行人不存在与此相关的纠纷或潜在纠纷;(3)发行人及其子公司所在地社保、公积金主管部门已经出具合规证明,证明发行人及子公司于报告期内不存在因违反社保、公积金方面法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形;(4)发行人实际控制人已经出具承诺,就发行人可能被要求补缴社会保险或可能承担的罚款或损失承诺承担赔偿责任,因此,本所律师认为,报告期内发行人曾有少量员工在其他单位缴纳社保、公积金的行为不属于重大违法违规行为,不会对发行人本次发行上市造成实质性影响。

(二) 针对未开户的情形,当前的整改情况

根据发行人提供的资料及其书面确认,报告期内,发行人及其子公司西安环宇芯存在公积金未开户的情形。针对上述情形,发行人已于 2019 年 10 月在成都住房公积金管理中心完成公积金开户并为员工缴存住房公积金,西安环宇芯已于 2019 年 1 月于西安住房公积金管理中心完成公积金开户并为员工缴存住房公积金。

综上所述,发行人及其子公司西安环宇芯未开户情形已整改完毕。

(三) 当前有关社保、公积金事项的合法合规性

1、发行人当前社保、公积金的缴纳情况

根据发行人提供的资料及其书面确认,截至 2021 年 6 月 30 日,发行人及其子公司社保和公积金缴纳的情况如下:

日期	项目	员工人数 (人)	已缴纳人 数(人)	未缴纳人 数(人)	未缴纳的原因
2021.6.30	养老保险	364	345	19	1 名军转干部, 17 名 退休返聘人员, 1 名当 月新入职员工
	医疗保险				
	工伤保险				
	失业保险				
	生育保险				
	住房公积金	364	333	31	17 名退休返聘人员, 14 名当月新入职员工 <small>注</small>

注: 14 名当月新入职员工中, 13 名为江苏七维当月新入职员工, 江苏七维已于当月为该等员工缴纳社保, 该等员工公积金已于次月缴纳; 1 名员工为西安环宇芯当月新入职员工, 该名员工社保、公积金已于次月缴纳。

截至 2021 年 6 月 30 日, 除 1 名军转干部, 17 名退休返聘人员, 1 名当月新入职员工以外, 发行人已为其所有在册员工缴纳社保; 除 17 名退休返聘人员, 14 名当月新入职员工以外, 发行人已为其所有在册员工缴纳公积金。

2、未缴纳社保、公积金的原因及其合法合规性

发行人未为上述员工缴纳社保、公积金的原因及其合法合规性如下: (1) 退休返聘人员与发行人签署劳务合同, 根据《中华人民共和国社会保险法》的规定, 发行人无需为其缴纳社保、公积金; (2) 按照《军队转业干部安置暂行办法》(中发[2001]3 号) 的相关规定, 军转干部按月领取退役金, 其基本医疗保险由无锡市退役军人事务局缴纳; (3) 当月新入职员工晚于公司当地社保公积金申报时间, 发行人已于次月为其缴纳。

综上所述, 本所律师认为, 发行人未为上述员工缴纳社保、公积金没有违反社保、公积金相关法律法规的规定。

3、发行人及其子公司所在地社保、公积金主管部门出具的证明

发行人及其子公司江苏七维、西安环宇芯所在地社保、公积金主管部门已出具合规证明, 确认截至 2021 年 6 月 30 日, 发行人及其子公司不存在因违反社保、公积金方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

（四）核查程序

就上述问题，本所律师履行了如下核查程序：

- 1、查阅了发行人及其子公司报告期期末及截至 2021 年 6 月 30 日的员工名册及相关员工出具的承诺；
- 2、查阅了发行人及其子公司报告期内及 2021 年上半年的社保、公积金缴费凭证；
- 3、查阅了发行人控股股东、实际控制人对执行社会保障、住房公积金制度的承诺；
- 4、取得并查阅了发行人及其子公司社保、公积金主管部门出具的合规证明；
- 5、查阅了《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》等社保、公积金相关法律法规的规定。

（五）核查意见

经核查，本所律师认为：

- 1、发行人报告期内曾经存在少量员工在其他单位缴纳社保、公积金的行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市造成实质性影响；
- 2、发行人当前社保、公积金的缴纳情况符合社保、公积金相关法律、法规的规定。

三、《审核问询函》问题 5

根据申报材料，发行人及其子公司拥有 10 项发明专利，其中 9 项为 2020 年获得，专利“用于搭载 IC 测试仪的霍尔传感器测试装置”分别作为两项发明专利于同一日获得。根据保荐工作报告，截至 2020 年 6 月末，发行人拥有发明专利不足 5 项，保荐机构督促发行人积极申请办理发明专利，在超过 5 项发明专利后申报。

请发行人说明：（1）“用于搭载 IC 测试仪的霍尔传感器测试装置”该专利同时申请两项发明专利的原因及合理性；（2）发行人当前 10 项发明专利应用于主

营业务的具体情况,是否满足“形成主营业务收入的发明专利不少于 5 项”的要求;

(3) 公司所拥有 10 项发明专利的申请时间、获批时间,相关发明专利与业务开展和核心技术的关系,研发投入情况,在报告期内所形成营业收入;(4) 2020 年 6 月后获批专利所对应技术的形成过程,与公司核心技术演进过程的匹配情况,2020 年 6 月后获批专利的发明人,是否为公司核心技术人员,申请至获批主要过程和时间节点,是否存在拼凑科创属性评价指标的情形。

请保荐机构、发行人律师核查并就发行人是否存在拼凑科创属性评价指标的情形、是否满足科创属性的要求发表明确意见,说明核查程序及核查证据。

回复:

(一)“用于搭载 IC 测试仪的霍尔传感器测试装置”该专利同时申请两项发明专利的原因及合理性

《招股说明书》第 9 项与第 10 项是两项不同的发明专利。第 9 项发明专利为“用于搭载 IC 测试仪的霍尔传感器测试装置”,第 10 项发明专利为“用于搭载 IC 测试仪的霍尔传感器测试方法”,即第 9 项是针对霍尔传感器测试开发的相关检测适配器等检测装置,而第 10 项是针对霍尔传感器测试开发的测试方法。两项发明专利所要求保护的技术方案不同,第 9 项专利是从硬件方面进行知识产权保护,第 10 项专利是从测试方法方面进行知识产权保护,因此针对霍尔传感器测试申请了两个专利,具有合理性。

(二)发行人当前 10 项发明专利应用于主营业务的具体情况,是否满足“形成主营业务收入的发明专利不少于 5 项”的要求

根据《招股说明书》、发行人提供的资料及其书面确认,发行人发明专利应用于主营业务的具体情况如下:

序号	专利名称	具体应用
1	一种半导体器件低温、高温在线测试装置	半导体分立器件不同温度下的测试
2	射频功率放大模块动态老化试验装置	射频功率放大模块(集成电路)的动态老炼试验
3	一种图形处理芯片 GPU 老化试验装置	GPU(集成电路)老炼试验
4	一种高速存储电路 DDR2 测试装置	DDR2(集成电路)的测试

序号	专利名称	具体应用
5	一种大功率 DC-DC 老化试验装置	DC-DC（集成电路）老炼试验
6	一种随机静态存储芯片 SRAM 功能测试装置	SRAM（集成电路）的功能测试
7	芯片用多工位卡脚方法	高速低功耗 DSP 电路及其他集成电路的测试
8	一种温度传感器液体环境晶圆级测试装置	温度传感器的测试
9	用于搭载 IC 测试仪的霍尔传感器测试装置	霍尔传感器的测试
10	用于搭载 IC 测试仪的霍尔传感器测试方法	霍尔传感器的测试

基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的合理判断，公司目前获得的 10 项发明专利均应用于主营业务，符合“形成主营业务收入的发明专利不少于 5 项”的要求。

（三）10 项发明专利的申请时间、获批时间，相关发明专利与业务开展和核心技术的关系，研发投入情况，在报告期内所形成营业收入

1、发明专利申请时间、获批时间及研发投入情况

根据《招股说明书》、发行人提供的资料及其书面确认，发行人获得的 10 项发明专利的申请、获批日期以及研发投入情况如下：

序号	专利名称	专利号	申请日期	获批日期	研发投入（万元）
1	一种半导体器件低温、高温在线测试装置	202010406298.1	2020-05-14	2021-02-05	13.36
2	射频功率放大模块动态老化试验装置	202010475673.8	2020-05-29	2020-12-07	240.16
3	一种图形处理芯片 GPU 老化试验装置	202010440350.5	2020-05-22	2020-12-17	65.93
4	一种高速存储电路 DDR2 测试装置	202010448450.2	2020-05-25	2021-01-21	61.65
5	一种大功率 DC-DC 老化试验装置	202010459749.8	2020-05-27	2021-03-22	69.38
6	一种随机静态存储芯片 SRAM 功能测试装置	202010448438.1	2020-05-25	2021-04-19	68.54
7	芯片用多工位卡脚方法	201811250920.3	2018-10-25	2020-03-20	124.57
8	一种温度传感器液体环境晶圆级测试装置	202010355274.8	2020-04-29	2020-12-17	65.79
9	用于搭载 IC 测试仪的霍尔传感器测试装置	202010355911.1	2020-04-29	2021-01-19	169.23

序号	专利名称	专利号	申请日期	获批日期	研发投入（万元）
10	用于搭载 IC 测试仪的霍尔传感器测试方法	202010359794.6	2020-04-29	2021-03-18	

2、相关发明专利与业务开展和核心技术的关系

根据《招股说明书》、发行人提供的资料及其书面确认，公司拥有的发明专利主要应用于集成电路、晶圆以及分立器件的检测业务中，公司发明专利形成的技术在具体业务开展中运用，具体情况说明如下：

序号	发明专利名称	与业务开展的关系	与核心技术的关系
1	一种半导体器件低温、高温在线测试装置	用于对半导体分立器件不同温度下的测试。该装置解决了原有技术易受外部环境因素影响导致测试精度低的问题，实现了对半导体器件的在线测试，提高了测试精度。	该项专利技术是“半导体分立器件测试与筛选试验技术”的组成部分。
2	射频功率放大模块动态老化试验装置	用于射频集成电路的老炼试验。此装置能够模拟在不同环境下的对射频功率放大模块进行老化，解决原有装置测试方法单一，在高温环境下，参数漂移导致无法正常运行的难题。	该项专利技术是“射频功率放大模块测试与筛选试验技术”的组成部分。
3	一种图形处理芯片 GPU 老化试验装置	用于 GPU 的老炼试验。该装置解决了现有技术中由于芯片安装结构复杂，散热效果不理想导致的问题，提高了 GPU 老炼试验数据的准确性。	该项专利技术是“图形处理芯片 GPU 测试与筛选试验技术”的组成部分。
4	一种高速存储电路 DDR2 测试装置	用于 DDR2 测试。原有装置对高速存储电路的控温效果较差，影响测试数据的准确性，此装置降低了高温对检测数据的影响，保证了测试数据的准确性。	该项专利技术是“高速存储电路 DDR2 测试与筛选试验技术”的组成部分。
5	一种大功率 DC-DC 老化试验装置	用于 DC-DC 老炼试验。此装置解决了原有装置因元器件电流调节不准确以及电流损耗等导致的试验数据不准确的问题，实现了在不同阻抗下对 DC-DC 的工作温度、过压欠压点以及老炼时间进行准确试验。	该项专利技术是“大功率 DC/DC 精准老炼试验技术”的组成部分。
6	一种随机静态存储芯片 SRAM 功能测试装置	用于 SRAM 的功能测试。此装置解决了原有技术仅能在常温状态下测试，不能精确测试芯片的工作性能问题，实现了不同温度下对芯片的测试，增	该项专利技术是“随机静态存储芯片 SRAM 测试与筛选试验技术”的组成部分。

		加了测试数据的全面性。	
7	芯片用多工位卡脚方法	用于固定芯片。该方法解决了制品上的芯片偏位、浮高等问题，提高了工作效率、减轻工作量。	该项专利技术是“高速低功耗 DSP 电路测试技术”的组成部分，也是其他集成电路测试技术的组成部分。
8	一种温度传感器液体环境晶圆级测试装置	用于温度传感器的测试。该装置解决了原有测试装置一次测试数量少、时间长、效率低的问题，减少了杂质对测试的影响，提供了测试的效率和准确性。	该三项专利技术是“晶圆测试技术”的组成部分。
9	用于搭载 IC 测试仪的霍尔传感器测试装置	用于霍尔传感器的测试。该数字电路测试装置解决了原有测试装置自动化程度不高、测试效率低的问题，方便搭载在 IC 测试仪上对霍尔传感器进行测试，提高了测试效率。	
10	用于搭载 IC 测试仪的霍尔传感器测试方法	用于霍尔传感器的测试。该测试方法通过采用新型测试手段提升了测试的效率与准确性。	

3、报告期内，发明专利所形成的营业收入情况

根据《招股说明书》、发行人提供的资料及其书面确认，发行人以发明专利形成的方法或装置可检测的具体型号元器件对应的营业收入，作为相关发明专利形成的营业收入的统计口径。报告期内，发明专利形成的营业收入具体情况如下：

单位：万元

序号	名称	2020 年	2019 年	2018 年
1	一种半导体器件低温、高温在线测试装置	3,579.23	1,541.10	1,091.69
2	射频功率放大模块动态老化试验装置	2,532.95	983.19	663.81
3	一种图形处理芯片 GPU 老化试验装置	3.37	-	-
4	一种高速存储电路 DDR2 测试装置	43.59	29.78	15.16
5	一种大功率 DC-DC 老化试验装置	845.30	477.16	488.69
6	一种随机静态存储芯片 SRAM 功能测试装置	87.00	31.21	-
7	芯片用多工位卡脚方法	6,016.59	3,484.78	2,411.68
8	一种温度传感器液体环境晶圆级测试装置	125.49	64.86	50.85
9	用于搭载 IC 测试仪的霍尔传感器测试装置	119.50	5.35	23.27
10	用于搭载 IC 测试仪的霍尔传感器测试方法	119.50	5.35	23.27

注：检测过程中同时使用发明专利相关技术导致其形成收入有重复计算的情形

(四) 2020年6月后获批专利所对应技术的形成过程，与公司核心技术演进过程的匹配情况，2020年6月后获批专利的发明人，是否为公司核心技术人员，申请至获批主要过程和时间节点，是否存在拼凑科创属性评价指标的情形。

1、2020年6月后获批专利所对应技术的形成过程，与公司核心技术演进过程的匹配情况

根据《招股说明书》、发行人提供的资料及其书面确认，公司发明专利所对应的技术为相应核心技术的组成部分，2020年6月后获批专利所对应技术的形成过程以及与公司核心技术演进过程的情况如下：

序号	专利	专利技术形成过程	核心技术演进过程
1	一种半导体器件低温、高温在线测试装置	<p>1、2017年，为了解决半导体器件原有高低温测试方法温度控制不准确，影响测试准确度，测试效率低的问题，公司安排开展了半导体器件高温、低温在线测试系统研究工作。</p> <p>2、2018年，发行人自主研发完成了第一代半导体器件高、低温在线测试装置，温度控制精度达到了$\pm 3^{\circ}\text{C}$，测量误差满足要求，基本满足当年检测工作需求。</p>	<p>半导体分立器件测试与筛选试验技术演进过程如下：</p> <p>1、2017年，在原有半导体器件测试与筛选试验技术基础上，发行人着手对简易硬件装置的改进研发。</p> <p>2、2018年，发行人自主研发完成了第一代半导体器件高、低温在线测试装置，并在实践中应用。</p> <p>3、2019年，发行人着手对零点漂移校准、时钟边沿比较测试、双脉冲测试等技术方法应用的研究，消除长线测试和分布参数影响带来的测试误差，提高了参数测试精度。</p> <p>4、2020年，发行人对测试装置及方法进行系统研发，并应用了多线程并行测试技术，提高了测试效率。</p>
2	射频功率放大模块动态老化试验装置	<p>1、2015年，公司基于以往射频功率放大模块老炼过程中易受干扰、易自激烧毁等问题，开始研发防自激、防干扰的射频功率放大模块的筛选试验装置。</p> <p>2、2017年，公司采用热设计、单电温度控制等技术，通过将隔离电路、F/V转换电路、功分电路相结合，开发了射频功率放大模块动态老化试验装置。</p>	<p>射频功率放大模块测试与筛选试验技术演进过程如下：</p> <p>1、2015年，公司为了解决以往射频功率放大模块测试、老炼过程中易受干扰、易自激烧毁等问题，开始研发防自激、防干扰的射频功率放大模块的测试与筛选试验技术。</p> <p>2、2017年，公司采用热设计、单点温度控制等技术，通过将隔离电路、F/V转换电路、功分电路相结合，开发了射频功率放大模块动态老化试验装置。</p> <p>3、2018年，公司运用EMC电磁兼容技</p>

序号	专利	专利技术形成过程	核心技术演进过程
		<p>射频功率放大模块动态老化试验装置。</p> <p>3、2018年，发行人对老炼装置进行 EMC 改进，解决了电磁兼容引起的干扰，防止高温动态老化时自激。</p>	<p>术、前置法和负反射法、自动扫频测试等技术，研发了一种防自激、防干扰测试及能够模拟在不同应用环境条件下的射频功率放大模块老炼系统。</p> <p>4、2019年，该系统广泛应用到高频/射频功率放大电路/模块可靠性检测。</p>
3	一种图形处理芯片 GPU 老化试验装置	<p>1、2019年，公司为解决以往老化试验只能通过加载电流进行长时间工作测试，耗时较久的同时在模拟高温灰尘场景下对电路寿命产生影响，老化试验数据有误的问题，研发老化试验装置。</p> <p>2、2020年，公司根据 GPU 老炼原理，运用电应力、温度应力、时间应力精准控制技术开发了适应各种不同环境、密封的、多工位的 GPU 老化试验装置。</p>	<p>图形处理芯片 GPU 测试与筛选试验技术演进过程如下：</p> <p>1、2017年，公司为适应国内 GPU 的国产化的研制及应用，公司开始同步研发图形处理芯片 GPU 测试与筛选试验技术。</p> <p>2、2019年，公司基于自动化测试平台，基于片段测试、剪裁测试以及 ALPHA 测试三种技术同步进行研发。</p> <p>3、2020年，公司基于 GPU 测试向量集，开发了 GPU 测试程序软件，解决了 GPU 无法测试或功能指标测试不全面、测试周期长等问题，实现了全自动化测试。</p> <p>4、2020年，公司根据 GPU 老炼原理，运用电应力、温度应力、时间应力精准控制技术开发了适应不同环境、密封的、多工位的 GPU 老化试验装置。</p> <p>5、2020年，该技术基本成熟，开始应用于小批量可靠性检测。</p>
4	一种高速存储电路 DDR2 测试装置	<p>1、2017年，为了解决以往暴露测试不能对测试环境进行精准控制、测试不稳定、精度差的问题，公司开始研发高速存储电路 DDR2 的测试装置。</p> <p>2、2018年，公司采用外部高精度定时控制、外部 FPGA 控制等技术，研制了一种针对高速存储电路 DDR2 的高稳定性、高精度的测试装置。</p>	<p>高速存储电路 DDR2 测试与筛选试验技术演进过程如下：</p> <p>1、2017年，为了满足日益增多的 DDR2 电路测试与筛选需求，提供更稳定和更精确的测试，公司开始研发针对高覆盖率、高精度高速存储电路 DDR2 的测试技术。</p> <p>2、2018年，公司采用外部高精度定时控制、外部 FPGA 控制等技术，研制了一种针对高速存储电路 DDR2 的高稳定性、高精度的测试装置。</p> <p>3、2018年，公司改进图形发生算法，开发专用时钟测试软件包，同时采用并行测试技术。该技术有效提高了 DDR2 测试覆盖率、参数完整性和测试效率。</p> <p>4、2019年，公司改进了老炼试验技术，形成了一套先进的高速存储电路 DDR2</p>

序号	专利	专利技术形成过程	核心技术演进过程
			测试与筛选试验技术，并在实际测试筛选过程中实现了批量应用。
5	一种大功率 DC-DC 老化试验装置	<p>1、2016 年，原有的 DC/DC 老炼试验方法存在电应力、温度应力、时间应力控制不准确导致难以达到有效老炼的目的，同时存在烧毁风险，公司开始研发大功率 DC/DC 精准老炼试验装置。</p> <p>2、2017 年，公司研发了特殊结构、特殊风道设计、定时巡检、单点温度控制的老炼装置。</p> <p>3、2018 年，公司开展双路并行 DC/DC 高温动态老化试验研究，运用双路电应力的施加、双路输出采样和控制技术，开发了并行老化试验装置。</p>	<p>大功率 DC/DC 精准老炼试验技术演进过程如下：</p> <p>1、2016 年，原有的 DC/DC 老炼试验方法存在电应力、温度应力、时间应力控制不准确导致难以达到有效老炼的目的，同时存在烧毁风险，公司开始研发大功率 DC/DC 精准老炼试验技术。</p> <p>2、2017 年，公司研发了特殊结构、特殊风道设计、定时巡检的老炼装置。</p> <p>3、2017 年，公司采用步进应力施加、回路监控补偿、红外热成像、单点温度控制、热阻分析及热仿真等技术，实现了电应力、温度应力和时间应力的精准控制，避免了 DC/DC 老炼过程中欠功率、超功率、欠温、超温、过载烧毁等风险，实现了对大功率 DC/DC 的精准老炼。</p> <p>4、2018 年，公司开展双路并行 DC/DC 高温动态老化试验研究，运用双路电应力的施加、双路输出采样和控制技术，提升了老化效率。</p> <p>5、2019 年、2020 年，公司在双路检测技术的基础上，进一步开发多路测试与老炼技术，该技术不断完善且已成熟应用。</p>
6	一种随机静态存储芯片 SRAM 功能测试装置	<p>1、2018 年，公司针对大容量的 SRAM 测试过程中发热快、测试温度控制不准的难题，着手研发 SRAM 测试温度精准控制装置。</p> <p>2、2019 年，公司从测试环境控制进行技术突破，应用半导体控温技术，研制了 SRAM 测试专用温度精准控制装置。</p>	<p>随机静态存储芯片 SRAM 测试与筛选试验技术演进过程如下：</p> <p>1、2018 年，公司针对大容量的 SRAM 测试温度控制不精确、测试效率低、测试成本高的难题着手进行研发。</p> <p>2、2019 年，公司从测试环境控制进行技术突破，应用半导体控温技术，开发了 SRAM 测试专用温度精准控制装置。</p> <p>3、2019 年，公司对原有的算法进行了改进，采用地址校验算法、棋盘型齐步算法等算法，提高了测试覆盖率和测试效率，并节约了测试成本。</p> <p>4、2019 年底，对随机静态存储芯片 SRAM 老炼等筛选试验同步进行了技术改进，形成了先进的随机静态存储芯片 SRAM 测试与筛选试验技术，并在实际测试筛选过程中实现了批量检测。</p>

序号	专利	专利技术形成过程	核心技术演进过程
			5、2020年，公司不断优化测试程序和检测适配器，实现了部分RAM全功能全参数测试，以及实时随机存储、实时擦除数据。
7	一种温度传感器液体环境晶圆级测试装置	1、2016年，为解决行业内只能将温度传感器封装后装放入温度试验箱中进行测试，无法实现晶圆级测试的技术难度，公司开始研发晶圆级测试装置。 2、2017年，公司开发了包括测试仪、安装有多个探针的探针卡，晶圆台盘以及贮有绝缘导热油的容器在内的装置，实现了一种温度传感器液体环境晶圆级测试。	晶圆测试技术演进过程如下： 1、2015年，发行人通过探针台和测试仪的改进，实现了数字集成电路晶圆芯片的多芯片同步测试。 2、2017年，公司对一些特殊芯片，如传感器芯片、熔丝修调电路设计、共电源或共地的晶圆测试还存在效率较低的问题，开展相应研发工作。 3、2018年，发行人基于IC测试系统，搭载自行研发的专用亥姆霍兹线圈磁场机构，研发了用于搭载IC测试仪的霍尔传感器测试装置；研发了该装置与IC测试仪搭载适配技术，形成了霍尔传感器搭载IC测试仪的测试方法。 4、2018年，在对分立器件和IGBT测试过程中，发行人基于先进机台，利用时序电路和测试仪的接口进行通讯，降低了成本，提高了测试效率以及通用性。 5、2018年，在集成电路测试过程中，发行人研究发现在带球面光源的半导体集成电路中测用针卡里，将点光源与球面反射体结合起来，制作成特殊的球面光源，光束可均匀的投射在集成电路晶圆表面，提高了光源和探针台以及测试仪适配性，满足了规模化生产的需求。
8	用于搭载IC测试仪的霍尔传感器测试装置	1、2017年，为解决霍尔传感器自动化程度不高，测试效率低的问题，发行人开始研发霍尔传感器测试装置。 2、2018年，发行人基于IC测试系统，搭载自行研发的专用亥姆霍兹线圈磁场机构，研发了用于搭载IC测试仪的霍尔传感器测试装置。	6、2019年，发行人研发了一种用于集成电路测试的晶圆盒，降低废品率，同时避免晶圆盒因抖动产生的位置偏移，减小抖动幅度。 7、2020年研发了一种温度传感器液体环境晶圆级测试装置，该装置能够将探针卡上的多个探针位置与单次所需测试芯片一一对应，实现了并行测试提升了效率。
9	用于搭载IC测试仪的霍尔传感器测试方法	1、2017年，为了解决霍尔传感器自动化程度不高，测试效率低的问题，发行人开始研发霍尔传感器测试方法。 2、2018年，发行人基于用于搭载IC测试仪的霍尔传感器测试装置，研发了该装置与IC测试仪搭载适配技术，形成了霍尔传感器搭载IC测试仪的测试方法。	

根据上表所述，基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的合理判断，

发行人 2020 年 6 月后获批专利所对应技术的形成过程以及与公司核心技术演进过程是匹配的。

2、2020 年 6 月后获批专利的发明人情况

根据《招股说明书》、发行人提供的资料及其书面确认，2020 年 6 月后，公司获批的专利的发明人情况如下：

序号	名称	专利号	发明人
1	一种半导体器件低温、高温在线测试装置	202010406298.1	马卫东、杜秋平、李亚飞、张鸿、李盼
2	射频功率放大模块动态老化试验装置	202010475673.8	杜秋平、马卫东、何建兵、陈惠玲、胡斌
3	一种图形处理芯片 GPU 老化试验装置	202010440350.5	马卫东、杜秋平、陈惠玲、胡斌、李亚飞
4	一种高速存储电路 DDR2 测试装置	202010448450.2	马卫东、杜秋平、王帅、何建斌、陈惠玲
5	一种大功率 DC-DC 老化试验装置	202010459749.8	杜秋平、马卫东、李盼、唐川、王帅
6	一种随机静态存储芯片 SRAM 功能测试装置	202010448438.1	杜秋平、马卫东、张鸿、李盼、唐川
7	一种温度传感器液体环境晶圆级测试装置	202010355274.8	杭晓宇、邹桂明、常兵、何芹、孔令丰
8	用于搭载 IC 测试仪的霍尔传感器测试装置	202010355911.1	齐和峰、赵健、陈元钊、施明明、孔令丰
9	用于搭载 IC 测试仪的霍尔传感器测试方法	202010359794.6	施明明、孔令丰、齐和峰、陈元钊、何芹

注：根据海军七〇一工厂于 2020 年 3 月 21 日出具的证明及项目组对马卫东的访谈，马卫东在海军七〇一工厂无职务发明，未申请知识产权。

除“一种温度传感器液体环境晶圆级测试装置”（专利号：202010355274.8）的发明人中无发行人核心技术人员参与外，其他发明专利均有发行人核心技术人员参与。

3、2020 年 6 月后获批专利的申请至获批主要过程和时间节点情况

根据《中华人民共和国专利法》的相关规定，专利从申请至获批的主要过程包括：申请、实质审查、陈述意见（或修改）、授予（或是驳回）。根据发行人提供的资料及其书面确认，公司 2020 年 6 月后获得的专利自申请至获批的主要过程及时节点如下：

序号	名称	申请日期	进入实质审查日期	优先审查日期	审查意见回复	获批日期
----	----	------	----------	--------	--------	------

序号	名称	申请日期	进入实质审查日期	优先审查日期	审查意见回复	获批日期
1	一种半导体器件低温、高温在线测试装置	2020-05-14	2020-08-27	2020-10-29	2020-12-03	2021-02-05
2	射频功率放大模块动态老化试验装置	2020-05-29	2020-08-31	2020-10-22	2020-11-02	2020-12-07
3	一种图形处理芯片 GPU 老化试验装置	2020-05-22	2020-09-07	2020-10-26	2020-11-12	2020-12-17
4	一种高速存储电路 DDR2 测试装置	2020-05-25	2020-08-31	2020-10-22	2020-11-18	2021-01-21
5	一种大功率 DC-DC 老化试验装置	2020-05-27	2020-07-23	2020-10-29	2020-11-11	2021-03-22
6	一种随机静态存储芯片 SRAM 功能测试装置	2020-05-25	2020-09-07	2020-10-26	2020-11-16	2021-04-19
7	一种温度传感器液体环境晶圆级测试装置	2020-04-29	2020-08-10	2020-08-28	2020-09-27	2020-12-17
8	用于搭载 IC 测试仪的霍尔传感器测试装置	2020-04-29	2020-08-10	2020-08-28	2020-09-27	2021-01-19
9	用于搭载 IC 测试仪的霍尔传感器测试方法	2020-04-29	2020-08-10	2020-08-28	2020-09-24	2021-03-18

根据《专利优先审查管理办法》（2017）（第 76 号）的规定，符合条件的专利可以申请优先审查。2020 年，发行人出于知识产权保护的需求，对部分成熟的技术陆续申请发明专利，因相关发明专利符合地方政府加速电子元器件产业特别是集成电路的快速发展政策，发行人发明专利申请符合《专利优先审查管理办法》优先审查的条件而获得优先审查，符合相关法规的要求。

4、是否存在拼凑科创属性评价指标的情形

根据发行人提供的资料及其书面确认，发行人主营军用电子元器件可靠性检测服务，其所处行业为技术密集型行业，发行人技术必须跟随电子元器件产品技术的发展趋势不断进步，以满足下游客户的可靠性检测需求，因此发行人高度重视技术研发，持续进行研发投入，经过多年的长期检测实践与技术沉淀，发行人在测试程序、检测装置以及检测方法等方面积累了较多的专有技术。

基于军工业务涉密性以及市场竞争方面的考虑，发行人过往对专有技术采取技术秘密的保护策略，公司制定了《文件管理办法》、《信息管控管理制度》等保密管理制度，公司设有专门的保密室，保密室及其他必要区域需严格执行相关管理规范，严禁携带手机等具备录摄功能的设备进入，并且公司与相关涉密岗位人员签署了保密协议。

在经营发展过程中，发行人逐步意识到专利的成功申请是公司长期技术积累成果的公开体现，能够说明公司的技术实力与水平，不仅有利于公司专有技术的保护，也有利于公司的业务拓展。报告期内，发行人针对专有技术的保护策略有所调整，增加申请专利的方式作为知识产权保护的策略之一。自 2018 年开始，发行人陆续开展申请专利的相关工作，发行人专利申请工作最初以实用新型专利申请为主，并辅以少量发明专利申请，也有部分技术既申请了实用新型专利又申请了发明专利。对于既申请了实用新型专利又申请了发明专利的情况（共 5 项），目前均已取得实用新型专利，相应的发明专利申请已进入实质审查阶段但尚未收到审查意见。同时申请实用新型专利和发明专利符合《专利法》等相关规定，是为了从时间和效力上更好地保护发行人的相关技术而采取的一种常见策略：实用新型的授权审核周期相对较短，在先取得授权后获得专利权保护，发明专利的授权审核周期相对较长，在取得发明授权前可由实用新型专利保护，当发明专利申请通过实质审查且可被授权后，发行人可选择放弃实用新型专利，取得发明专利。

2018 年、2019 年，发行人陆续取得专利主要是实用新型专利，而发明专利较少，主要原因：一是专有技术保护策略调整初期，申报的发明专利数量较少；二是对部分技术采用发明专利和实用新型专利同时申请的策略，优先取得了实用新型专利，发明专利的申请仍在实质审查中，若发明专利申请通过审查且可被授权，发行人将放弃实用新型专利，取得发明专利。

2020 年初，发行人在股改前进一步梳理完善公司内部控制过程中，基于专有技术保护角度及商业策略考虑，确定了持续申请专利的需求计划，所以发行人基于较多的专有技术储备，在总结此前发明专利申请经验的基础上，将部分已成熟运用的检测装置以及少量的检测方法申请发明专利。2020 年度发行人申报的发明专利申请陆续获得授权，该等发明专利技术是利用公司自身的工作条件和设备形成的，是发行人长期技术研发积累的体现，也从侧面印证了发行人的技术能力与水平。

综上所述，发行人不存在拼凑科创属性评价指标的情形。

（五）核查程序

就上述问题，本所律师履行了如下核查程序：

1、获取了发行人拥有的专利证书，查阅了发明专利说明书，了解了发明专利对应的装置与方法的区别及联系，明确了发明专利的获取方式；

2、访谈了核心技术人员，获取了发明专利具体应用的业务合同，查阅了发明专利说明书，分析了发明专利在公司实际检测业务中所起的作用，了解了发明专利的技术创新性以及对检测效率、精度等的改进情况；

3、查询了国家专利局网站，梳理了发明专利自申请至获批的主要时间节点；访谈了核心技术人员，收集了研发投入资料，统计分析了发明专利的研发投入情况；获取了发明专利对应的元器件检测业务合同，统计了发明专利形成的主营业务收入情况；

4、访谈了核心技术人员，获取了研发项目立项、验收等资料，分析了发明专利与核心技术演进情况的匹配关系；访谈了发明专利发明人，了解了发明人在发明专利中承担的工作及贡献情况；

5、获取了发明专利优先审查申请文件，查阅了专利优先审查法规相关要求，分析了发明专利优先审查的合规性；

6、访谈了核心技术人员，获取了保密相关的管理制度，通过国家专利局等网站查询了专利的状态，对比分析了发明专利与实用新型专利的申请进度情况，了解了发行人的专利申请策略。

（六）核查意见

经核查，基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的合理判断，本所律师认为，发行人的发明专利均为自主研发，发明专利的获得是公司长期技术积累成果的体现，发明专利的申请是基于技术发展以及对专有技术进行保护的需要，不存在拼凑科创属性评价指标的情形；发行人拥有形成主营业务收入的发明专利超过 5 项，满足科创属性的相关要求。

四、《审核问询函》问题 9

根据申报材料，发行人已经获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）、国防科技工业实验室认可委员会（DILAC）实验室认证等相关

资质。CNAS 实验室认可和 DILAC 实验室认可虽不是从事检测业务的法定必备资质，但该等认可对行业内企业的业务发展具有重要作用。

请发行人披露：(1) 发行人所处行业开展检测筛选等业务法定必备资质和非法定资质的具体情况，并对招股说明书资质部分内容进行标注、修改；(2) 获得发行人所述 CNAS、DILAC 等资质认证的具体难度、技术门槛等；获得上述资质能够开展发行人相同业务的企业（或单位）的数量、企业（或单位）性质等情况。

请发行人说明：发行人开展上述业务是否需要取得涉军工等行业特殊资质、许可或其他要求，并结合上述披露的资质的情况，说明发行人开展业务有“资质壁垒”的说法是否准确。

请发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

（一）发行人开展上述业务是否需要取得涉军工等行业特殊资质、许可或其他要求

根据《武器装备科研生产许可管理条例》《武器装备科研生产许可实施办法》，从事武器装备科研生产许可目录所列的武器装备科研生产活动，应当申请取得武器装备科研生产许可。

根据《中国人民解放军装备承制单位资格审查管理规定》《关于进一步加强装备承制单位资格审查工作的通知》，装备承制单位资格审查是指军队装备部门对申请装备承制资格的单位进行审查、审核、注册和监督管理等一系列活动。装备承制单位，是指承担武器装备及配套产品科研、生产、修理、技术服务任务的单位。装备承制单位资格经审查、核准后，由总装备部统一注册，编入《装备承制单位名录》。自 2011 年 1 月起，凡与军方直接签订装备采购合同的承制单位，必须具备装备承制单位资格。

根据《武器装备质量管理条例》的规定，武器装备以及用于武器装备的计算机软件、专用元器件、配套产品、原材料的质量管理，适用该条例。国务院国防科技工业主管部门和总装备部联合组织对承担武器装备研制、生产、维修任务单位的质量管理体系实施认证，对于武器装备的通用零（部）件、重要元器件和原

材料实施认证。根据中央军委装备发展部相关规定，从2017年10月1日起，将武器装备质量管理体系审核与装备承制单位资格审查两项活动，合并为统一组织实施的装备承制单位资格审查活动，一次审查作出结论，发放一个证书，即装备承制单位资格证书。发行人子公司西安环宇芯取得武器装备质量管理体系认证证书，主要是当时考虑该认证可能对其业务拓展有帮助，西安环宇芯实际上未从事武器装备及配套产品的研制、生产、维修等活动，其目前业务开展无须取得该项认证。

根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》的规定，对承担涉密武器装备科研生产任务的企事业单位，实行保密资格审查认证制度，该单位应当取得相应保密资格。发行人及其子公司取得相关保密资格证书主要考虑取得该等证书对其业务拓展有帮助，实际上未承担涉密武器科研生产任务，不存在接收与业务相关的涉密文件的情况。

根据发行人提供的资料及其书面确认、以及本所律师访谈发行人相关人员，发行人主要从事军用电子元器件可靠性检测服务，不涉及上述规则所规定的武器装备及配套产品的科研、生产、维修、技术服务等活动，也未承接涉密武器装备科研生产任务。因此，上述军工资质不属于发行人开展业务所需的法定必备资质。

但由于发行人主要与军工客户或涉军企业发生业务关系，部分客户会从自身企业性质及业务管理要求角度出发对其供应商提出各项具体要求，除了CNAS实验室认可以及DILAC实验室认可这两项对发行人从事业务有重要作用的资质认可外，包括建立具备健全的保密制度、获得保密资格等相关资格、认定或认证证书也都会对发行人拓展其业务产生一定的帮助。基于客户要求及为拓展业务需要，发行人及其子公司取得了相关保密资格证书，发行人子公司西安环宇芯取得武器装备质量管理体系认证证书。

（二）结合上述披露的资质的情况，说明发行人开展业务有“资质壁垒”的说法是否准确

根据《招股说明书》、发行人提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，发行人所处行业开展军用电子元器件可靠性检测等业务虽不存在法定必备资质，但由于发行人主要与军工客户或涉军企业发生业务关系，该等客户从自身企业性质及业务管理要求的角度出发对其可靠性检测服务供应商有明确的资质要求，主

要涉及 CNAS 实验室认可、DILAC 实验室认可。进入客户供应商名录以及获取客户信任的核心因素是可靠性检测技术获得认可，而获得客户技术认可的前提就是要求供应商具备相关资质，因此要进入军用电子元器件可靠性检测服务行业就必须取得客户要求的资质。

如《招股说明书》“第六节 业务与技术”之“二、(三)、3、(4)”之“A. 资质壁垒”部分披露，获取及维持 CNAS、DILAC 认可具有一定难度和技术门槛，具体体现在：(1) 申请人应建立了符合认可要求的管理体系，且正式、有效运行 6 个月以上；(2) 申请人应有足够的、持续不断的检测/校准/鉴定经历予以支持。如近两年没有检测/校准/鉴定经历，原则上不予受理；(3) 申请人需具有足够的温度、湿度、洁净度及防静电受控的固定场地、专用设备，要有具有相应专业背景、学历水平、从业经历的专业技术人员队伍；(4) 评审程序流程复杂，获取 CNAS、DILAC 认可须经过意向申请、正式申请、评审准备、文件评审、现场评审和认可批准等多项程序；(5) 现场评审是申请 CNAS、DILAC 认可的核心环节，认可机构在本环节中将派出专家评审组通过现场观察、查阅文档及相关文件、安排现场试验、考核授权签字人、现场提问等考核手段考核申请人；(6) 获 CNAS、DILAC 认可实验室须接受定期（通常为认可批准后 12 个月内）和不定期的监督评审，以及定期复评审（通常为每两年一次）。

根据本所律师检索 CNAS 官网（<https://www.cnas.org.cn>）下设的“获认可的实验室名录”专栏，在该专栏的查询条件“检测对象”中分别输入“元器件”、“电子元器件”、“集成电路”、“晶圆”、“分立器件”、“阻容感”作为关键词，检索得出对应获得 CNAS 实验室认可的企业（或单位）一共 216 家（以下简称“CNAS 名单”）²。

由于 DILAC 认可数据为非强制公开披露信息，本所律师未能从公开渠道查询获得 DILAC 认可企业（或单位）的准确名单及完整数量。根据发行人介绍，虽然在规则层面，CNAS、DILAC 认可不存在申请的先后顺序要求或互为先决条件的情形，但 CNAS 认可是对各行业实验室的通用要求，DILAC 认可是在此基础上突出了国防科技工业对检测和校准实验室的特殊要求，因此上述两个认可的申请评审标准存在一些相同部分；在实操中，通常先取得 CNAS 认可才能申请

² CNAS 名单的统计截止时间为 2021 年 8 月 4 日。

DILAC 认可或两者同时申请。基于以上情况，本所律师以 CNAS 名单为基础，通过检索该名单下企业（或单位）官网等公开信息，核实其是否取得 DILAC 认可情况。

根据上述途径查询，除发行人及其子公司以外，与发行人从事相同或相似业务的企业，并同时获得 CNAS 认可、DILAC 认可资质的企业共 38 家，其中民营检测服务企业 8 家³。上述通过公开查询得到的数据结果虽为不完全统计，但与发行人对行业内企业所了解的相关情况基本一致。从上述检索情况来看，同时获得 CNAS 认可、DILAC 认可并与发行人从事相同或相似业务的企业数量较少，也在一定程度上说明了存在技术门槛。

因此，本所律师认为，发行人开展军用电子元器件可靠性检测业务有“资质壁垒”的说法准确。

（三）核查程序

就上述问题，本所律师履行了如下核查程序：

1、登陆 CNAS 官网，并查阅《国防科技工业实验室认可委员会章程》，对 CNAS 及 DILAC 的基本情况、评审流程及考核标准进行查询；

2、查阅《实验室认可规范》、CNAS/CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-A003：2019《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》、DILAC/AC01：2018《检测实验室和校准实验室能力认可准则》等规则，了解获取及维持 CNAS、DILAC 认可的难度和技术门槛；

3、登陆 CNAS 官网查询获得 CNAS 实验室认可，并从事电子元器件检测的企业名单，在上述名单的基础上通过公开渠道筛选出同时获得 DILAC 认可的企业名单，将上述通过公开查询得到的名单与发行人确认，确认该名单的数据结果与发行人对行业内所了解的相关情况基本一致；

4、查阅《武器装备科研生产许可管理条例》《武器装备科研生产许可实施办法》《中国人民解放军装备承制单位资格审查管理规定》《关于进一步加强装备承制单位资格审查工作的通知》《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办

³ 因公开资料有限，且相关企业（或单位）官网等公开信息可能存在未及时更新的情形，故同时获得 CNAS 实验室认可、DILAC 认可的企业（或单位）数据的系不完全统计，且数据可能存在滞后性。

法》《武器装备质量管理条例》等规定，了解发行人从事业务是否需取得军工行业特殊资质；

5、查阅发行人及其子公司取得的武器装备科研生产单位保密资格证书及武器装备质量管理体系认证证书；

6、查阅主要竞争对手的资质取得情况；

7、与发行人高级管理人员及核心技术人员沟通了解 CNAS、DILAC 认可的申请流程、申请考核标准及维持条件等相关情况，了解在国防科工系统开展检测/校准工作的实验室申请 CNAS 认可、DILAC 认可的实际情况；了解发行人取得武器装备科研生产单位保密资格证书及武器装备质量管理体系认证证书的背景和原因；

8、查阅《招股说明书》。

（四）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、CNAS 实验室认可、DILAC 实验室认可及涉军工等行业特殊资质、许可不属于发行人开展业务所需的法定必备资质；

2、发行人主要与军工客户或涉军企业发生业务关系，该等客户从自身企业性质及业务管理要求的角度出发对其可靠性检测服务供应商有明确的资质要求，主要涉及 CNAS 实验室认可、DILAC 实验室认可；获取及维持 CNAS、DILAC 认可具有一定难度和技术门槛；同时获得 CNAS 认可、DILAC 认可并与发行人从事相同或相似业务的企业数量较少。因此，发行人开展军用电子元器件可靠性检测业务有“资质壁垒”的说法准确。

五、《审核问询函》问题 12

招股说明书披露，2018 年、2019 年，发行人子公司江苏七维存在通过关联方进行银行转贷的情形，其中部分资金存在放贷时间与转回时间间隔较长或转回时间早于放贷时间的情形。

请发行人说明：（1）公司与关联方在报告期内的资金往来情况，包括资金拆

借、货款结算等，资金往来认定为转贷的标准和方法；（2）关联方获得转贷资金后未及时转回或分批转回的原因，间隔期间的资金流向。

请保荐机构、申报会计师对转贷转回时间间隔较长或转回时间早于放贷时间的情形进一步核查并说明核查结论及核查证据。

请发行人律师对转贷行为的合法合规性、是否构成重大违法违规事项发表明确核查意见。

回复：

（一）转贷行为的合法合规性

根据《贷款通则》，借款人不按借款合同规定用途使用贷款的，由贷款人对其部分或全部贷款加收利息；情节特别严重的，由贷款人停止支付借款人尚未使用的贷款，并提前收回部分或全部贷款。

转贷行为未严格遵守发行人与银行之间对资金用途的约定及《贷款通则》等法律法规的规定。根据上述《贷款通则》规定，转贷行为可能导致银行停止支付公司尚未使用的贷款并提前收回部分或全部贷款。

根据发行人的确认，发行人已通过纠正不当行为、改进制度、加强内控等方式积极整改，2019年9月以后未再发生转贷情形，此前转贷相关银行借款均已按期偿还，未给相关贷款银行造成损失。发行人将上述转贷资金用于日常经营活动，该行为不属于主观故意或恶意行为。

（二）贷款银行及相关监管部门的说明

上述转贷业务涉及的江苏银行股份有限公司无锡诚业支行、宁波银行股份有限公司无锡分行于2021年3月9日出具《确认函》，确认江苏七维在该行未发生逾期还款或者其他违规情形，未给该行造成资金损失，在该行无不良贷款记录。

中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局（以下简称“**银保监无锡分局**”）于2021年7月15日出具《中国银保监会无锡监管分局关于江苏七维测试技术有限公司相关业务合规情况的函》，经该局核查，自2018年1月1日至该函出具之日，江苏七维与无锡辖内银行机构业务未发生不合规的情形。

（三）转贷行为是否构成重大违法违规事项

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》（以下简称“《审核问答》”）第三条的规定，最近3年内，发行人及其控股股东、实际控制人在国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域，存在以下违法行为之一的，原则上视为重大违法行为：被处以罚款等处罚且情节严重；导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等。

结合上述《审核问答》第三条对“重大违法行为”的解释，鉴于：（1）江苏七维上述转贷行为不属于国家安全、公共安全、生态安全、公众健康安全领域违法违规行为；（2）截至本回复出具之日，江苏七维未因转贷行为而受到相关监管部门处罚，亦未被认定为情节严重；（3）江苏七维转贷所涉及的相关银行贷款已经偿还，转贷行为已经整改，且银保监会无锡分局及转贷涉及的商业银行已针对江苏七维的合法合规经营情况出具相关证明文件；（4）上述转贷行为未导致重大环境污染、重大人员伤亡、社会恶劣影响；本所律师认为，江苏七维的转贷行为不构成重大违法违规事项，不会对发行人本次发行构成实质性障碍。

（四）核查程序

就上述问题，本所律师履行了如下核查程序：

1、获取了发行人的内部控制制度，访谈发行人相关人员，了解发行人是否建立了完善的内部控制制度；

2、参与核查关联方资金往来、转贷的资金流水及相关凭证，就江苏七维报告期内曾经发生的转贷业务，获取转贷业务涉及银行出具的确认函，核查是否存在逾期还款或其他违规情形、是否给银行造成资金损失、是否在该等银行存在不良贷款记录；

3、取得并查阅了银保监会无锡分局于2021年7月15日出具的《中国银保监会无锡监管分局关于江苏七维测试技术有限公司相关业务合规情况的函》；

4、访谈发行人相关业务的负责人，了解关联方资金占用的背景，对相关关联方进行问询，了解相关资金占用的用途；

5、查询中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>），核查发行人是否存在

诉讼纠纷情况：

6、核查《贷款通则》等文件了解相关规定。

（五）核查意见

经核查，本所律师认为，发行人子公司江苏七维的转贷行为不构成重大违法违规事项，不会对发行人本次发行构成实质性障碍。

六、《审核问询函》问题 23.3

根据公开资料，发行人子公司西安环宇芯被申请诉前财产保全。

请发行人说明：上述法律纠纷的具体情况，当前最新进展；结合西安环宇芯在发行人业务开展中的角色和作用，说明上述纠纷是否对发行人产生重大不利影响。

请发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

（一）上述纠纷的具体情况，当前最新进展

根据发行人提供的西安环宇芯与西安凌霄电子科技有限公司（以下简称“凌霄电子”）签署的购销合同、付款凭证及与凌霄电子相关诉讼的裁判文书，本所律师在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）查询的结果，以及发行人的书面确认，上述纠纷的具体情况如下：

2018年4月3日，西安环宇芯与凌霄电子签署《购销合同》，约定西安环宇芯向凌霄电子采购精密LCR表、精密阻抗分析仪等产品，合同价款合计722,500元。根据合同约定，西安环宇芯应在合同签订后支付订货款50%即361,250元，到货验收后付清50%余款共计361,250元。西安环宇芯于2018年5月9日支付了订货款361,250元，凌霄电子于2018年7月28日向西安环宇芯履行了交货义务。

由于西安环宇芯彼时资金紧张，未及时支付余款共计361,250元，凌霄电子于2019年7月30日向西安市雁塔区人民法院申请诉前财产保全，申请冻结西安

环宇芯在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行账户中的银行存款。西安市雁塔区人民法院经审理后，于2019年8月9日作出（2019）陕0113号财保754号民事裁定书，裁定冻结西安环宇芯在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行账户中的银行存款共计382,925元。

上述裁定作出后，西安环宇芯于2019年8月22日向凌霄电子支付了剩余货款361,250元。凌霄电子于2019年8月26日向西安市雁塔区人民法院申请解除对西安环宇芯的上述财产保全，西安市雁塔区人民法院经审查后于2019年9月2日作出（2019）陕0113财保807号民事裁定书，裁定解除对西安环宇芯在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行账户中的银行存款共计382,925元的冻结。上述裁定已执行完毕。

（二）结合西安环宇芯在发行人业务开展中的角色和作用，说明上述纠纷是否对发行人产生重大不利影响

西安环宇芯主要从事军用电子元器件可靠性检测服务业务，与发行人主营业务相同；西安环宇芯地处西安，对于发行人在西北区域市场的业务布局具有重要作用。上述纠纷为正常商业往来中的合同纠纷，合同标的较小，且西安环宇芯已支付完毕合同款项，财产保全已解除。因此，本所律师认为，上述纠纷不会对发行人产生重大不利影响。

（三）核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了如下核查程序：

- 1、登陆中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）查询西安环宇芯与凌霄电子案件的基本情况；
- 2、取得并查阅了西安环宇芯与凌霄电子案件相关的裁判文书；
- 3、取得了西安环宇芯与凌霄电子签署的购销合同及相关付款凭证、设备验收单；
- 4、查阅了中汇会计师事务所出具的发行人报告期的《审计报告》；
- 5、取得了发行人出具的书面确认。

经核查，本所律师认为，西安环宇芯与凌霄电子之间的纠纷为正常商业往来

中的合同纠纷，合同标的较小，且西安环宇芯已支付完毕合同款项，财产保全已解除。因此，上述纠纷不会对发行人产生重大不利影响。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市之补充法律意见书(一)》的签字页)

北京市君合律师事务所 (盖章)



负责人: _____

华晓军 律师

魏伟 律师

刘鑫 律师

安明 律师

2021 年 8 月 10 日